

令和3年度 京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

令和3年4月23日
京都府中小企業技術センター
担当: 応用技術課
電話: 075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマとして、その解決を目的とした「京都実装技術研究会」を設置しています。

この度令和3年度の会員を募集するため、オープニングセミナーを以下のとおり開催します。

- 1 日 時 令和3年5月25日(火) 13:30~17:00
- 2 開催方式 Web / 会場参加 併用 (講師はWeb でのご講演)
- 3 会 場 京都府産業支援センター 5階 研修室
(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)
- 4 内 容

○講演1 「最新半導体事情～米中問題から車載用 IC 不足まで」

講師 ^{つだ けんじ}津田 建二 氏 / 国際技術ジャーナリスト兼セミコンポータル編集長

AI やDX (デジタルトランスフォーメーション)、5G などこれから成長が期待される分野には半導体が威力を発揮します。半導体産業がどう変わってきて今どういう状況なのか。AI やDX、5G、さらには米中問題から最近の車載不足に至るまで、現状を解説します。

○講演2 「5G の国内外の展開と産業応用動向」

講師 ^{ふじおか まきのぶ}藤岡 雅宣 氏 / エリクソン・ジャパン株式会社 チーフ・テクノロジー・オフィサー (CTO)

5G の仕組みや主な技術についてまとめた後、世界及び日本での5G の展開状況や主なサービスについて概観し、今後期待される産業界での5G のユースケースや5G 利用で期待される恩恵についてまとめます。

- 5 定 員 Web : 応募状況により調整 会場 : 若干名
- 6 参加費 無 料
- 7 申込締切 令和3年5月21日(金) まで
- 8 申 込 先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係 (中川)
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp
※ホームページ(<https://www.kptc.jp/>)からも申込みができます。

